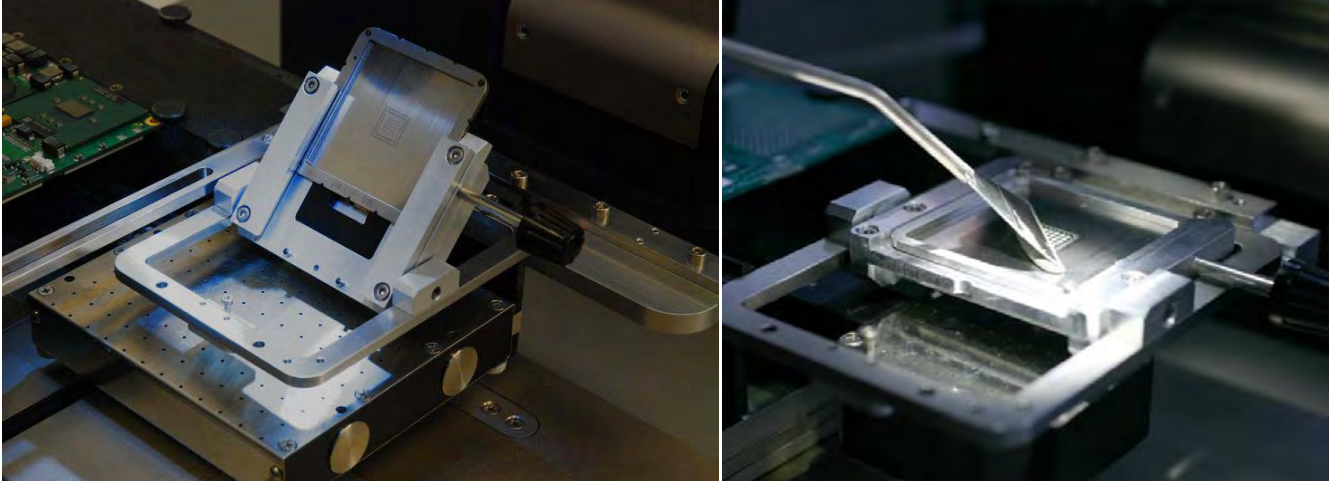


FINEPLACER® DCP-Modul



Das DCP-Modul (Direct Component Printing Module) ist die Komplettlösung für die Reparatur von QFN, SON und MLF Komponenten. Als integraler Bestandteil des Reparatursystems kann mit Hilfe des DCP-Moduls Frischlot direkt auf die Bauteile gedruckt werden.

Das direkte Bedrucken des Bauteils mit Lot ist eine besonders effektive, unkomplizierte und zeitsparende Methode, den Ertrag bei der Fine Pitch QFN/MLF-Reparatur zu erhöhen. Integriert in ein FINEPLACER® Reworksystem, ermöglicht das Bauteil Bedruck-Modul den einen Prozessschritt, um eine reproduzierbare, sequenzielle Lösung zu bekommen.

Die Kontaktpads des Bauteils werden präzise zur Schablone ausgerichtet und Frischlot wird direkt auf das Bauteil gedruckt. Dann wird das Bauteil an den Lötarm transferiert und anschließend mittels Vision Alignment System zum Substrat ausgerichtet. Dank der Genauigkeit sind selbst Bauteile mit besonders kleinem Pitch kein Problem.

Direct Component Printing ist eine besonders effektive, sichere und zeitsparende Methode, um die Ausbeute in der Reparatur von Leadless Komponenten deutlich zu erhöhen.

Eigenschaften*

- Minimiert Wärmebelastung auf Board und Bauteil entsprechend JEDEC/IPC Standards
- Reparaturergebnis in Erstausrüster-Qualität, da nur ein thermischer Prozess nötig
- Geeignet für Reparatur von QFN/MLF in kleinen und großen Stückzahlen
- Optimiertes Schablonendesign mit optionaler Nano-Beschichtung, 100% kompatibel mit älteren DCP-Modulen
- Lasergeschnittene Durchbrüche für hochgenaues Druckbild, geeignet für Fine Pitch Applikationen
- Schneller werkzeugloser Schablonenwechsel für kurze Umrüstzeiten
- Lotpastenauftrag mit jedem FINEPLACER® Reworksystem
- Bauelementgröße (max.): 20 x 20 mm²
- Pitch- Abstand: >400µm

* je nach Konfiguration